

证券代码：688261

证券简称：东微半导

## 苏州东微半导体股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

(2021 年度业绩说明会暨现金分红说明会)

编号：IR2022-003

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>电话会议  <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>通过线上方式参与公司 2021 年度业绩说明会暨现金分红说明会的投资者</p>
<p>会议地点</p>	<p>网络互动 价值在线 (www.ir-online.cn)</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>龚轶 (董事长兼总经理)、李麟 (董事兼董事会秘书)、谢长勇 (财务负责人)、毕嘉露 (独立董事)</p>
<p>交流时间</p>	<p>2022 年 05 月 17 日 10:00-11:00</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题一：祝贺贵司 Tri-gate IGBT 产品在去年首次量产出货取得非常好的成绩。请问今年该产品的订单量如何？产能如何？</p> <p>答：2021 年公司基于自主专利技术的 650V、1200V 及 1350V 新一代 IGBT 器件技术 TGBT 研发成功并实现量产出货，在光伏逆变器、储能、充电桩、电机驱动等领域获得客户的批量订单。2022 年 1 季度 TGBT 产品的销售增速较快，具体订单及产能情况、销售金额等详细信息请见公司 2022 年后续定期报告。</p>

问题二：如何看待目前国家层面对半导体行业的政策支持？未来会持续多久？

答：半导体产业作为信息产业的基础，发展程度是国家科技实力的重要体现，是信息化社会的支柱产业之一，更对国家安全有着举足轻重的战略意义。国家相关政策的陆续出台从战略、资金、专利保护、税收优惠等多方面推动半导体行业健康、稳定和有序的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。我们相信国家层面对半导体行业的政策支持会是长期的、有效的。

问题三：晶圆代工价格全面调涨，公司将如何应对，未来是否有产能保障？

答：随着下游需求持续扩张以及上游原材料供应紧张对全球晶圆代工行业产能带来的影响，晶圆代工行业普遍出现产能紧张的情况，进一步导致了晶圆价格的增长。公司与上游晶圆制造企业华虹半导体、粤芯半导体及 DB Hitek 等厂商继续保持稳定的业务和技术合作关系，产能持续扩大，有效保障公司的新产品研发有序推进并满足客户不断增长的需求。

问题四：从公司披露的年报和一季报信息来看，一季度净利润环比有所下降，请问是什么原因？

答：尊敬的投资者您好，此次说明会主要针对 2021 年公司业绩及分红情况进行说明。2022 年一季度净利润环比下降问题此前公司也已进行过说明回复，具体如下：2022 年一季度的毛利率较上年同比、环比均实现增长，同时，2022 年一季度利润总额较上年四季度环比亦实现了增长，而 2022 年一季度净利

润之所以较上年四季度环比下降，主要系：公司于2021年四季度重新获得高新技术企业资格，2021年度享受按应纳税所得额的15%计缴企业所得税，因此，2021年前三季度按所得税税率25%预缴税金与实际应缴税金的差异主要体现在2021年四季度所得税费用中。

问题五：公司的核心技术有哪些？目前公司各产品线的技术水平如何？

答：目前公司的主要产品包括 GreenMOS 系列高压超级结 MOSFET、SFGMOS 系列及 FSMOS 系列中低压屏蔽栅 MOSFET。同时，公司已开发了超级硅 MOSFET 及 Tri-gate 结构 IGBT（“TGBT”）等先进功率器件产品。在 MOSFET 领域，公司拥有深槽超级结 MOSFET 设计及其工艺技术（国内领先，国际先进）、屏蔽栅结构中低压 MOSFET 设计及其工艺技术（国内领先）以及 Super-Silicon 超级硅 MOSFET 设计及其工艺技术（国际先进）等核心技术；在 IGBT 领域，公司拥有 Tri-gate 结构 IGBT 器件设计及其工艺技术的核心技术（国际领先）；基于 Tri-gate 结构 IGBT 器件的基础，公司还创新地提出了新型功率器件结构与技术，并命名为 Hybrid-FET 器件及其工艺技术（国内领先）；新型第三代半导体器件设计及工艺技术，SiC 器件（目标达到国际先进）。

问题六：公司未来三年的主要发展战略是什么？有哪些发展目标？

答：首先，公司持续专注于研发高效率、低损耗的产品，通过对器件底层技术的创新，全面实现对高性

能功率半导体技术领域的全覆盖，实现相关国产功率器件的自主可控；业务方面，公司始终专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域，布局长期高增长的下游产业领域，通过与各领域头部客户的深入合作，实现长期可持续发展。其次，深化与上下游优秀合作伙伴的合作，实现双赢；为了更好地指引公司未来的发展，在经营模式方面，公司将深化与上下游优秀合作伙伴的合作，使公司的技术创新能力与代工合作伙伴的制造能力深度结合，创造出更优秀的产品。这种紧密合作可以进一步深化双方的信任，强化双方的技术优势和产能优势，提升双方的价值。最后，探索资源整合的方式，加速产品能力提升；除了通过内生发展的方式提高产品能力外，公司将探索并购整合的方式加速产品能力的提升。在公司核心产品高性能功率器件产品上，公司将通过并购整合具有创新与技术能力的车规级功率器件设计企业、SiC 功率器件设计及应用能力的企业，结合公司自身的创新技术与工艺能力经验，进一步提升在车规级功率器件领域的产品开发能力以及在先进材料领域的高性能功率器件产品开发能力。同时，公司亦会探索上下游资源整合的路径，进一步提高公司产品的竞争力以及丰富产品结构。

问题七：请简单介绍公司上市后股东分红回报政策。

答：公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的股利分配政策。公司在制定利润分配政策和具体方案时，充分听取中小股东、独立董事和监事的意见，重视投资者的合理回报需要，并兼顾公司长远利益和可持续发展，

	保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，积极采取现金方式分配利润。
附件清单	无
日期	2022年05月17日